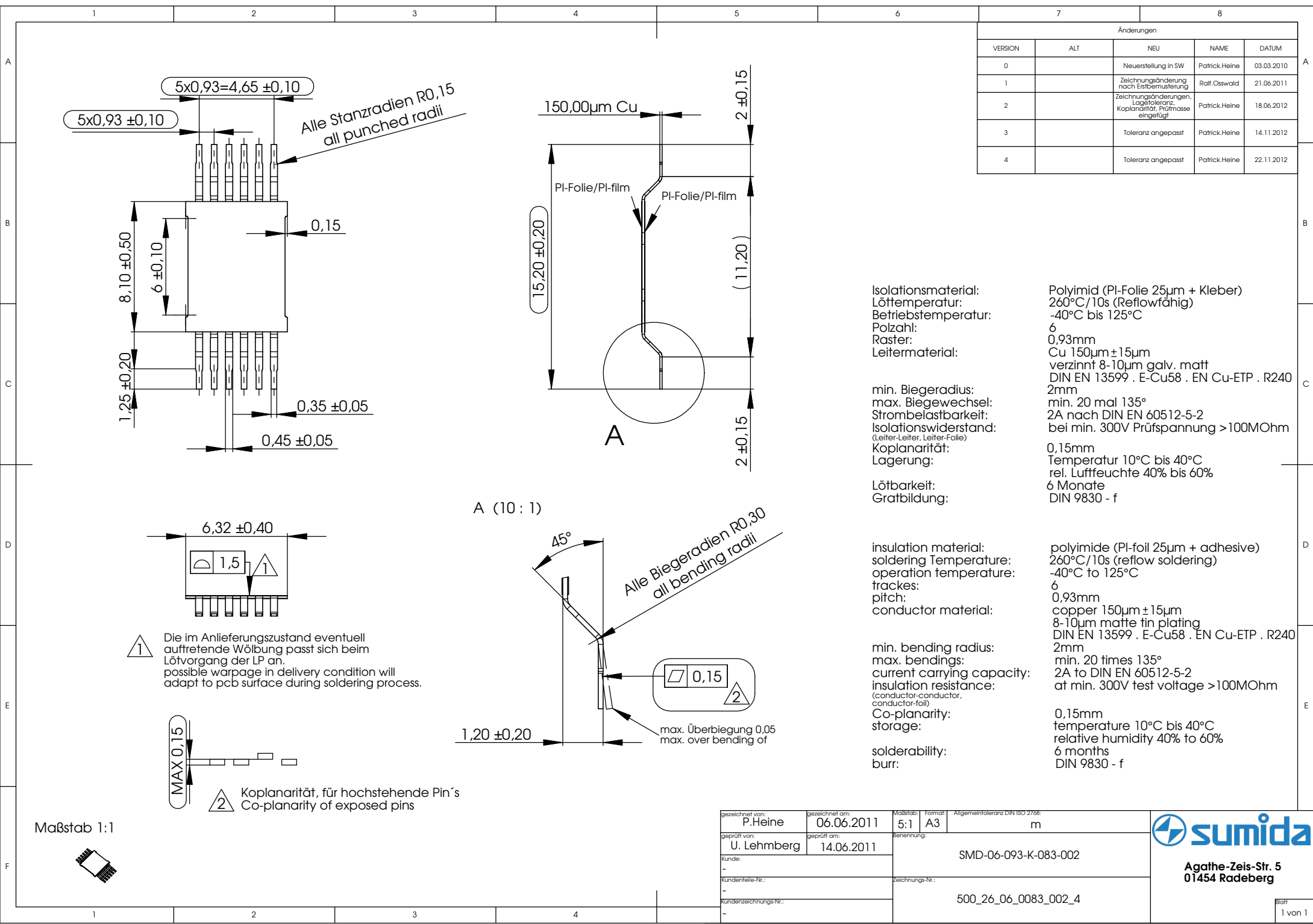




Änderungen				
VERSION	ALT	NEU	NAME	DATUM
0		Neuerstellung in SW	Patrick.Heine	03.03.2010
1		Zeichnungsänderung nach Erstbemusterung	Ralf.Osswald	21.06.2011
2		Zeichnungsänderungen, Lagetoleranz, Koplanarität, Plafmasse eingefügt	Patrick.Heine	18.06.2012
3		Toleranz angepasst	Patrick.Heine	14.11.2012
4		Toleranz angepasst	Patrick.Heine	22.11.2012

Isolationsmaterial:
Löttemperatur:
Betriebstemperatur:
Polzahl:
Raster:
Leitermaterial:

min. Biegeradius:
max. Biegewechsel:
Strombelastbarkeit:
Isolationswiderstand:
(Leiter-Leiter, Leiter-Folie)
Koplanarität:
Lagerung:

Lötbarkeit:
Gratbildung:

insulation material:
soldering Temperature:
operation temperature:
tracks:
pitch:
conductor material:

min. bending radius:
max. bendings:
current carrying capacity:
insulation resistance:
(conductor-conductor, conductor-foil)
Co-planarity:
storage:

solderability:
burr:

Polyimid (PI-Folie 25µm + Kleber)
260°C/10s (Reflowfähig)
-40°C bis 125°C
6
0,93mm
Cu 150µm ± 15µm
verzinkt 8-10µm galv. matt
DIN EN 13599 . E-Cu58 . EN Cu-ETP . R240
2mm
min. 20 mal 135°
2A nach DIN EN 60512-5-2
bei min. 300V Prüfspannung >100MΩ
0,15mm
Temperatur 10°C bis 40°C
rel. Luftfeuchte 40% bis 60%
6 Monate
DIN 9830 - f

polyimide (PI-foil 25µm + adhesive)
260°C/10s (reflow soldering)
-40°C to 125°C
6
0,93mm
copper 150µm ± 15µm
8-10µm matte tin plating
DIN EN 13599 . E-Cu58 . EN Cu-ETP . R240
2mm
min. 20 times 135°
2A to DIN EN 60512-5-2
at min. 300V test voltage >100MΩ
0,15mm
temperature 10°C bis 40°C
relative humidity 40% to 60%
6 months
DIN 9830 - f

gezeichnet von: P.Heine	gezeichnet am: 06.06.2011	Maßstab: 5:1	Format: A3	Allgemeintoleranz DIN ISO 2768: m
geprüft von: U. Lehmberg	geprüft am: 14.06.2011	SMD-06-093-K-083-002		
Kunde: -				
Kundenzeile-Nr.: -				
Kundenzeichnungs-Nr.: -				
		Zeichnungs-Nr.: 500_26_06_0083_002_4		



Maßstab 1:1

